

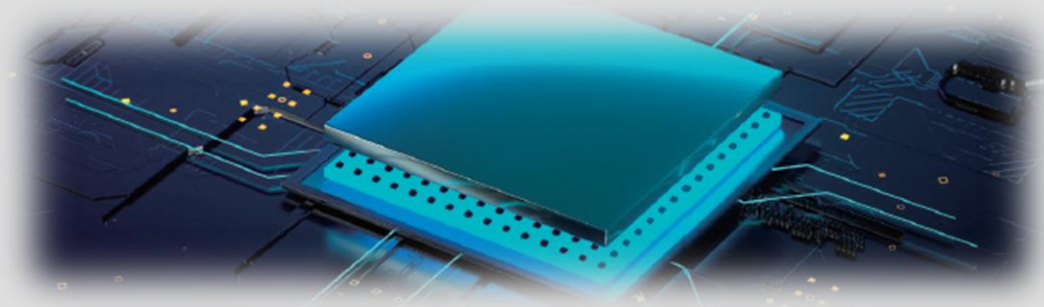
TORAY IR Day
中期経営課題“IGNITION 2028”事業説明会

エンジニアリング事業

2026年6月8日

東レ株式会社
上席執行役員 関連事業本部長
井上 薫

東レエンジニアリング株式会社
代表取締役社長
岩出 卓



INDEX

目次

I	東レGのエンジニアリング事業	P.3-5
----------	-----------------------	--------------

II	東レエンジニアリング株式会社(TRENG)	P.6-23
-----------	------------------------------	---------------

1.概況	P.6-11
2.事業概要と成長戦略	P.12-18
3.次世代・サステナビリティへの取り組み	P.19-21
4.目標	P.22-23

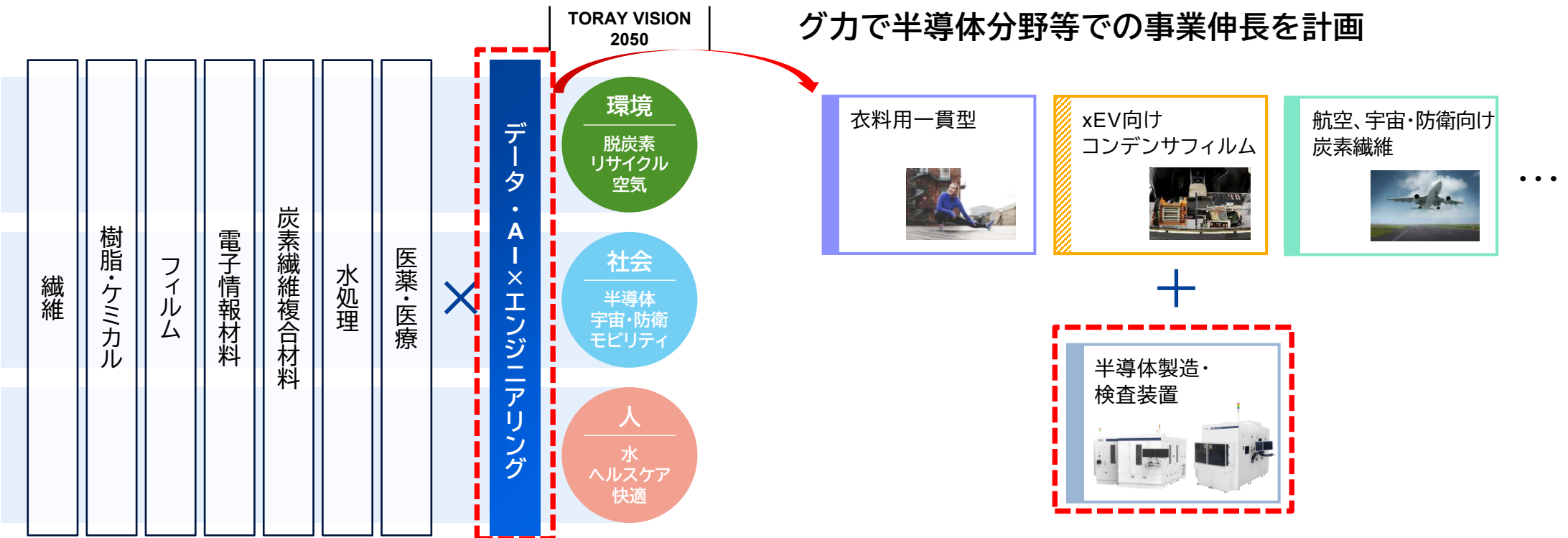
I

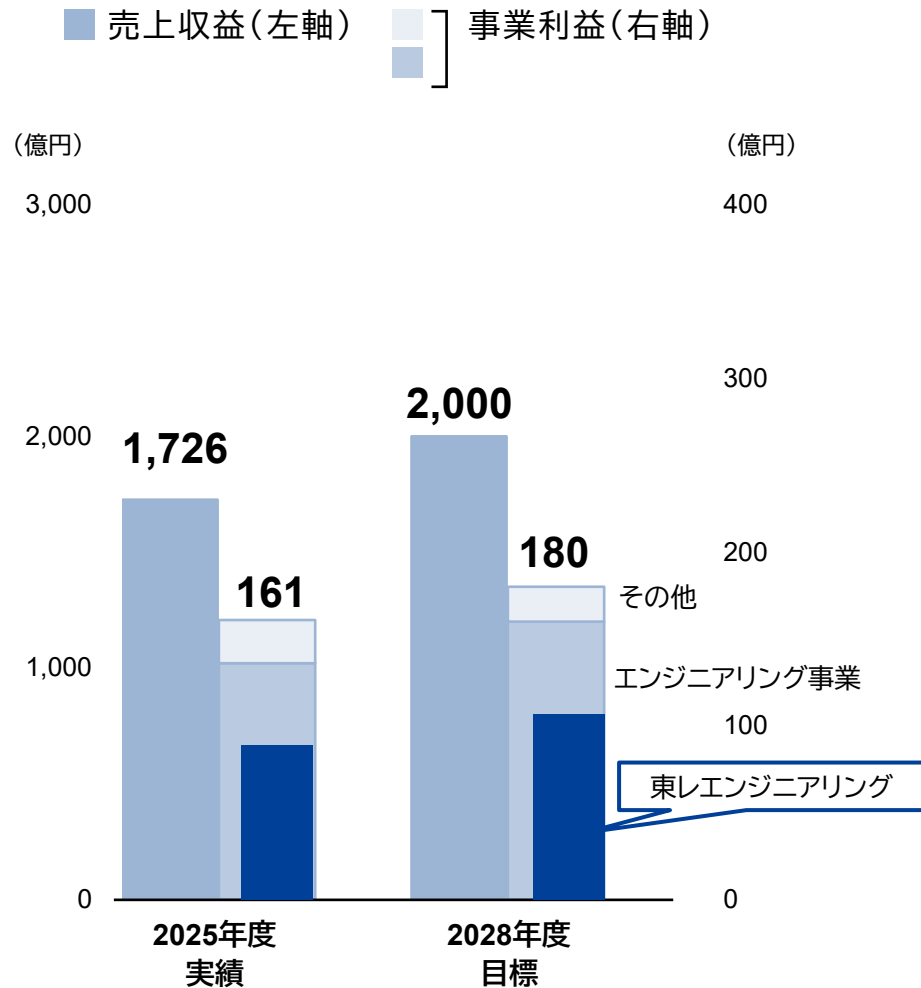
東レGのエンジニアリング事業

環境・社会・人に対する社会課題や事業環境の変化に対し、各事業の強みとデータ・エンジニアリング力を掛け合わせることで、リスクを機会に変えながら、経済的価値・社会的価値の創出を目指す

事業による社会課題の解決、機会の獲得を通じ、
経済的価値・社会的価値を創出

東レグループが開発する技術・製品の社会実装(機械製作・プラント建設)だけでなく、磨かれたエンジニアリング力で半導体分野等での事業伸長を計画





エンジニアリング事業他

- エンジニアリング、分析等、東レグループの製品・技術を社会実装するために不可欠な事業会社等を有す
- 「エンジニアリング事業」に属する東レエンジニアリング株式会社(以下、TRENG)は、創業66年、機器製作、プラント建設、電子機器事業等で、エンジニアリングに関する多種多様な知見を蓄積した事業を展開
- 東レグループが中長期の成長市場とする半導体領域については、TAB製造装置から連なる技術で高い評価を受けており、IGNITION 2028では着実に業績を伸長させる計画

Ⅱ-1

東レエンジニアリング株式会社(TRENG) －TRENG概況－

1. 東レエンジニアリング株式会社(TRENG)概況

設立	1960年
本社所在地	本社 東京都中央区八重洲一丁目3番22号 (八重洲龍名館ビル6階)
	関西本社 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 (東レ滋賀事業場内)
資本金	15億円
売上収益 (連結)	1,214億円 (2026年3月期)

代表取締役社長

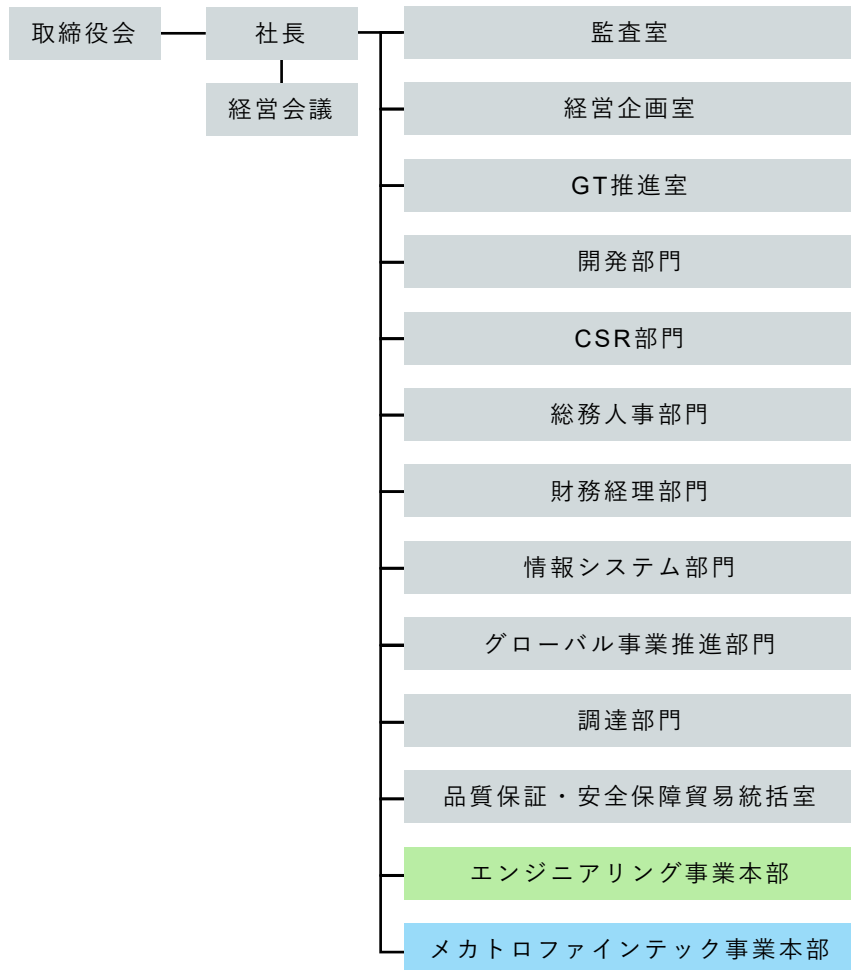
岩出 卓 (いわで・たかし)



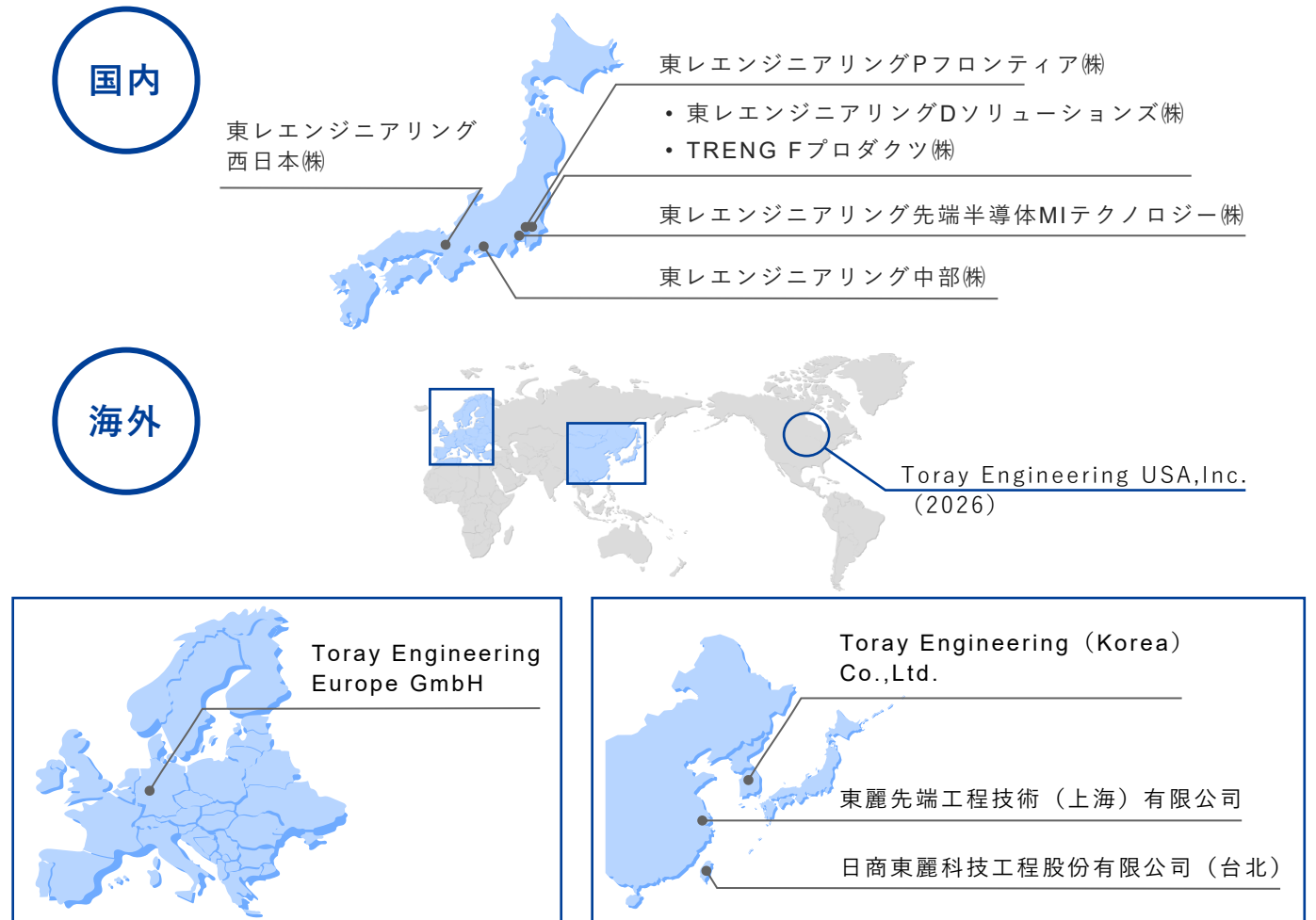
従業員数 (連結)	2,072人 (2026年3月末現在)
国内事業拠点	<ul style="list-style-type: none">■ 瀬田工場 (滋賀県)■ FAイノベーションセンター (静岡県)■ 横浜技術センター
	<ul style="list-style-type: none">■ 東京オフィス■ 大阪オフィス■ 名古屋オフィス

2. 組織と関係会社

組織図

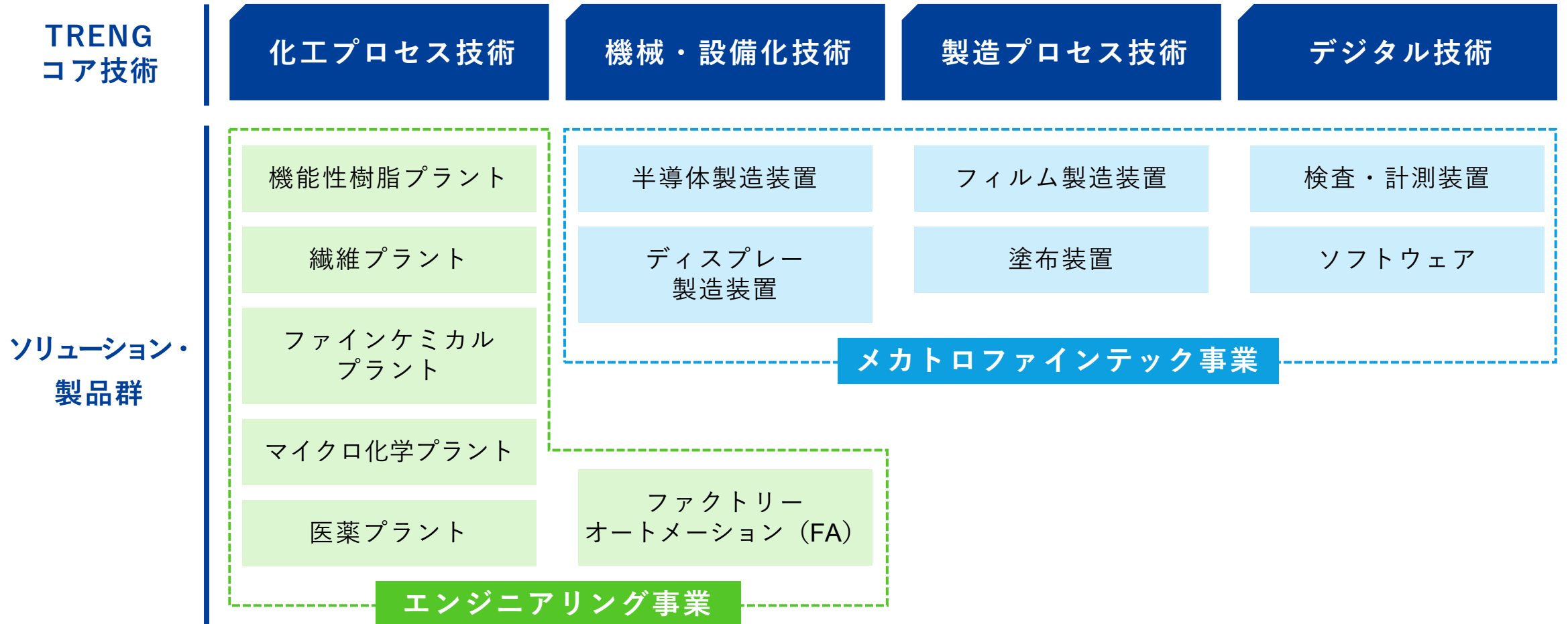


主な関係会社



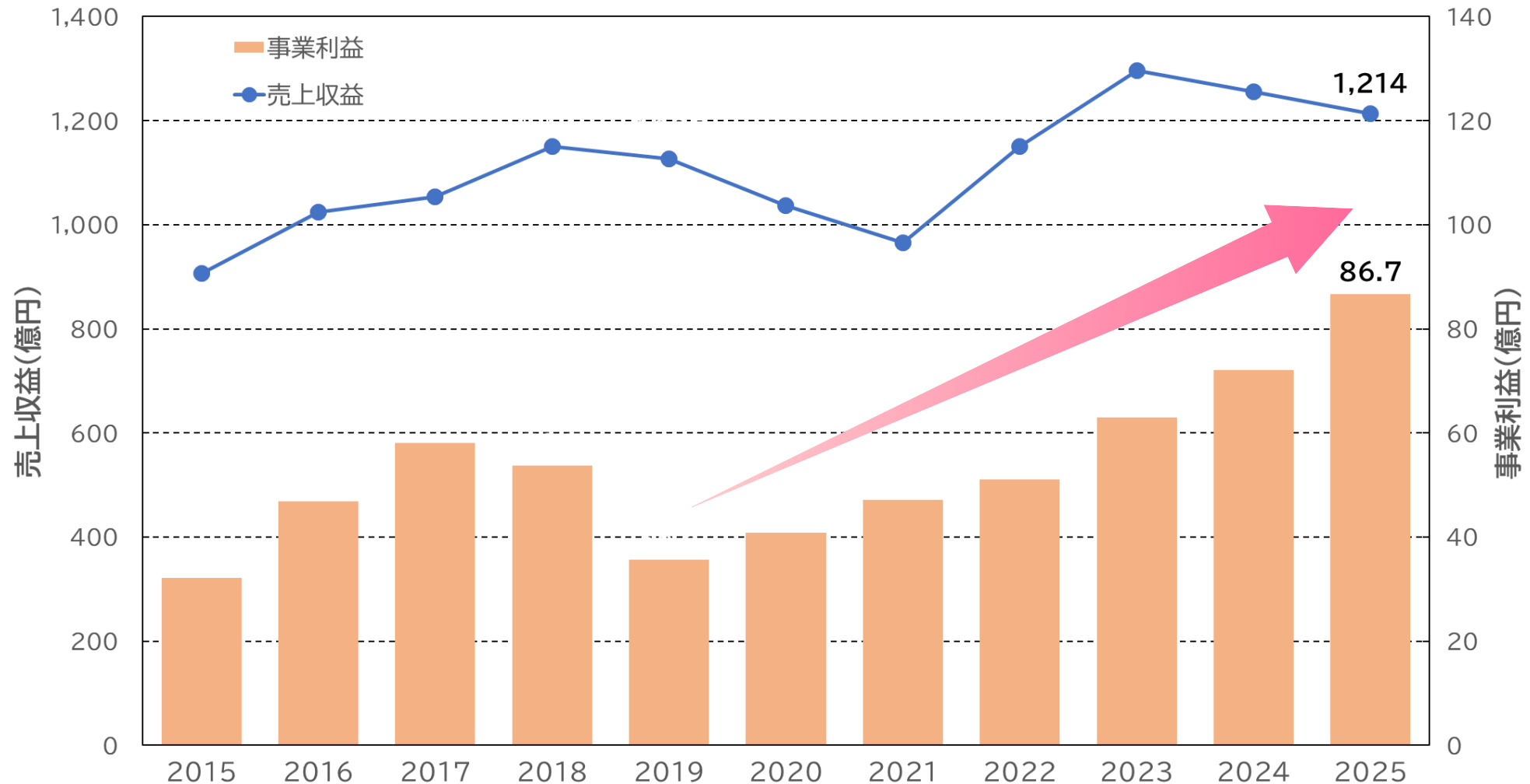
3. 保有技術と事業・製品群

- 4つのコア技術から多様な技術・ソリューションを創出し、
プラントエンジニアリングから製造設備・システムまで幅広く事業を展開



4. 業績推移

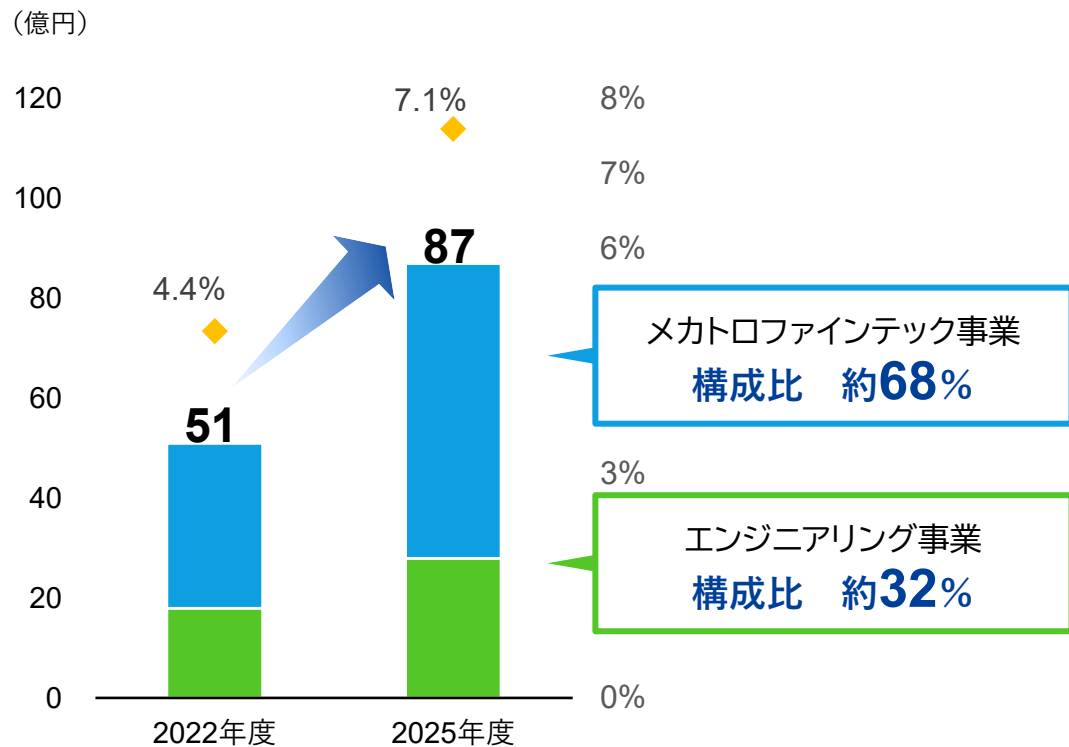
収益改善の推進と半導体等成長領域での事業拡大により、2019年以降、6年連続の増益



5. AP-G 2025振り返り

厳しい事業環境で推移したが、生産性向上による利益率改善に取り組み、事業利益は大幅な増益
成長領域を有するメカトロファインテック事業は堅調に伸長

事業利益・事業利益率



【課題と成果】

■ 成長領域へのコミット

- ・医薬製造プラント(エンジニアリング事業)
 - ・二次電池(LIB)(メカトロファインテック事業)
 - ・半導体関連(検査装置・実装装置)(//)
- トランプ関税政策の影響から厳しい事業環境が継続するも、受注伸長

■ 経営基盤強化

- ・生産性向上による収益率改善
→利益率約3%改善
- ・技術力向上、人材戦略、ブランド戦略
→DX・教育・人材投資、事業ブランド「TRENG」設定

【2026年度以降中経への課題】

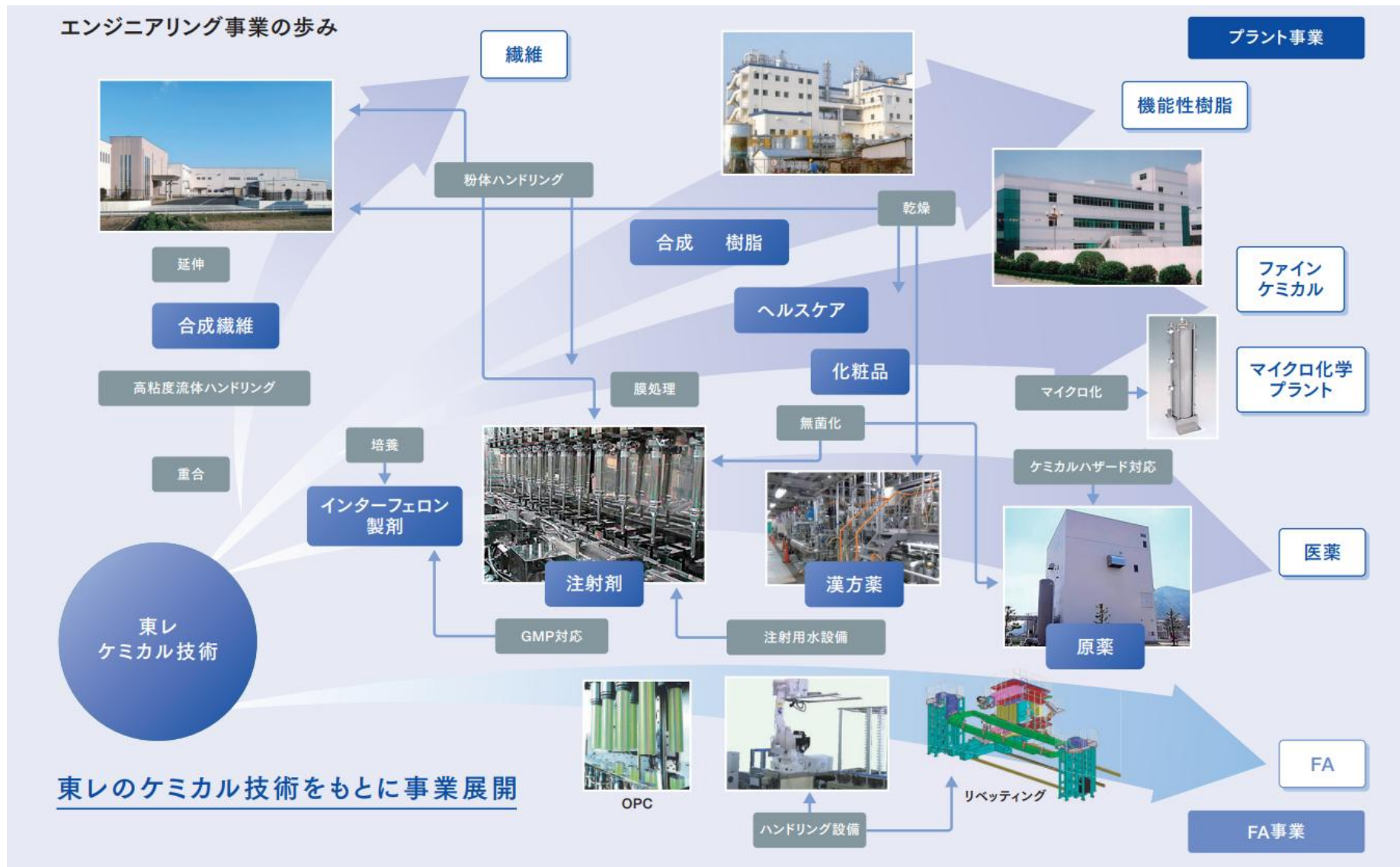
- 中長期拡大に向けた体質強化(成長戦略・構造改革)

Ⅱ -2

TRENG事業概要と成長戦略

－エンジニアリング事業・ メカトロファインテック事業－

1-1. エンジニアリング事業



1-2. エンジニアリング事業の概要と強み

・ 先端素材の製造を支えるプラント・設備を提供

プラントエンジニアリング

- 各種ケミカルプラントの設計から施工までトータルサービスを提供
- 医薬プラントにおいては、発酵・培養プラントや医薬中間体・合成原薬製造プラントを中心に積み重ねてきた技術力をもとに提案型エンジニアリングを実行
※ISPE Japan 参画企業

International Society for Pharmaceutical Engineering (国際製薬技術協会)

Engineering
設計

Procurement
調達

Construction
施工

■ 事例： 医薬プラント

薬理活性の高い「高薬理」原薬に対し、治験パイロットから商業大容量プラントまで「封じ込め」技術を適用



高薬理治験パイロットプラント



高薬理大容量プラント

安全性・作業性を両立
したプラントを実現

FA (ファクトリーオートメーション)

ロボットを活用した自動生産システムを設計・製作



■ 事例： EV・HEV向け製造設備

車載モーターの製造工程向けに、塗布・検査自動化など最適なソリューションを提供



材料ロスの低減や高効率化に貢献

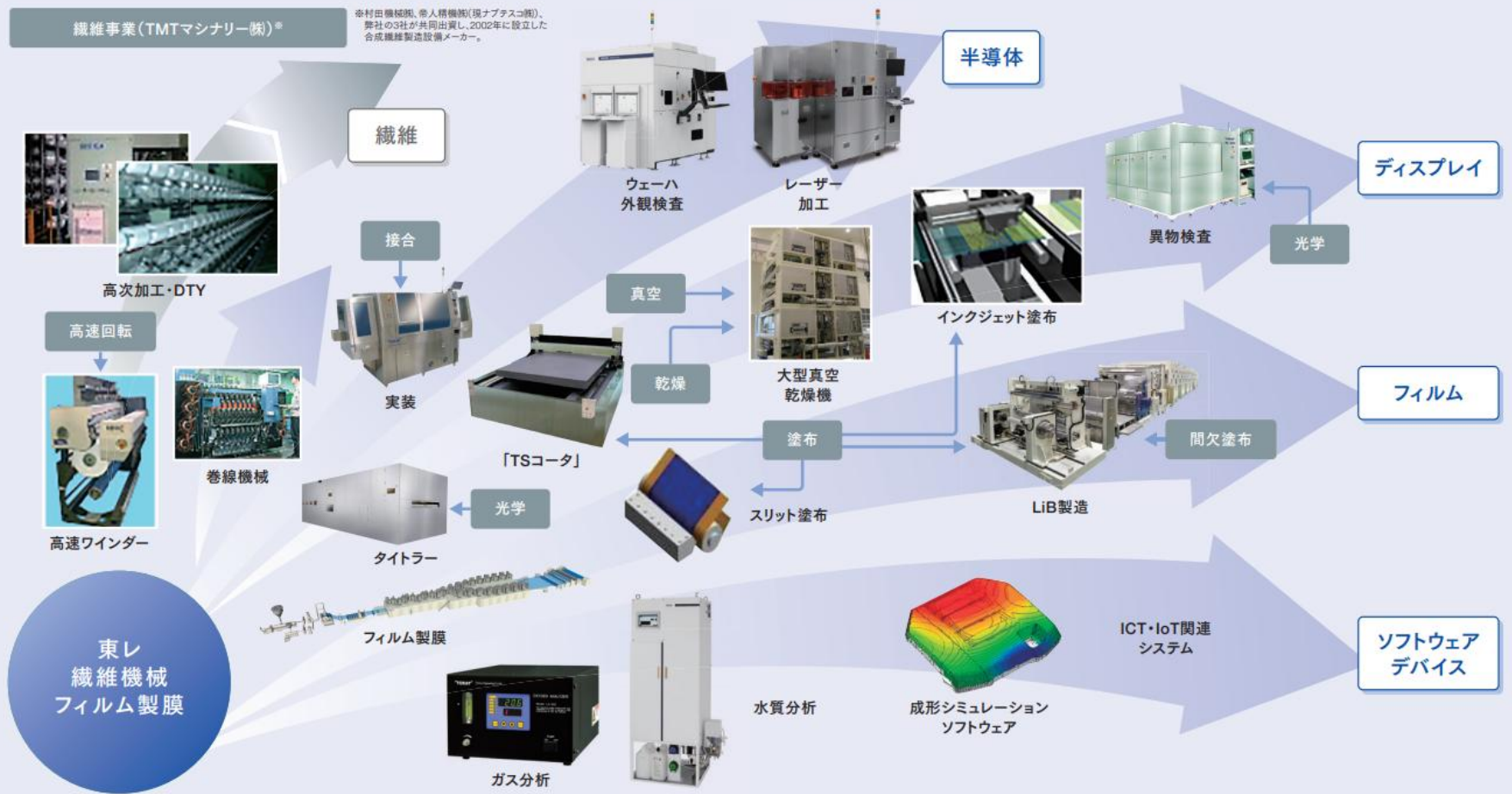
メンテナンス

グループ会社を通じてスピーディーで細やかな設備保全サービスを提供



2-1. メカトロファインテック事業

メカトロファインテック事業の歩み



東レの繊維機械やフィルム製膜の保有技術をもとに 事業展開



2-2. メカトロファインテック事業の概要と強み

- メカトロニクスと微細加工技術を融合し、最先端のソリューションを提供

ディスプレイ・半導体製造装置

ディスプレイや半導体分野向けに最先端の装置・ソリューションを提供

■ 電子線式ウェーハ検査・計測装置(NGR®)

- 広く歪の少ない視野&Die to Database技術により先端半導体の開発に貢献。
- 先端半導体向けに、開発から量産工場での採用拡大を目指して活動中。



■ 事例: PLP関連装置「PLPコーター/ボンダー」

- PLP(パネルレベルパッケージ)用の大型基板向け装置
- PLPはデータサーバー等のハイエンド用途での採用が期待される3次元半導体パッケージ技術

PLPコーター



PLPボンダー



フィルム製造装置

「塗る・貼る・切る」コンバーティング技術をベースに、フィルム製造で培った二次加工装置、製膜装置を展開

■ 事例: リチウムイオン電池用電極製造装置

- 塗布やものづくりの高度な技術が評価
- 多くの電池メーカーが当社コーター・スリッター装置を採用

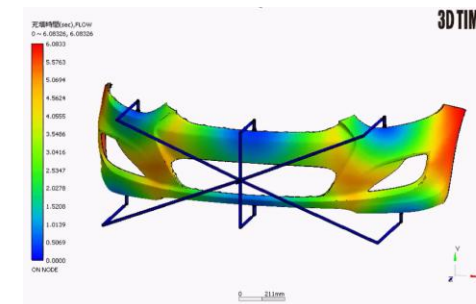


ソフトウェア・検査・計測装置

“ファクトリーAI”として、工場管理・生産管理システムやCAEシステムを提供

また、工程監視・改善向けに、計測・分析・プロセス装置を提供

※CAE(Computer Aided Engineering)

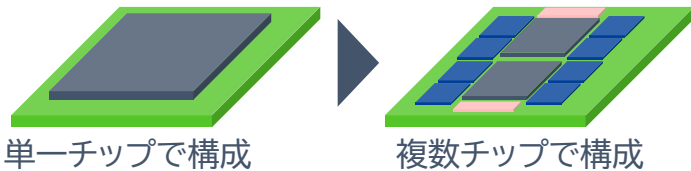


2-3. 参考資料 PLP(Panel Level Package)関連装置

ハイエンド半導体パッケージの技術トレンド

1) チップレット

複数の半導体チップを1パッケージ化し高性能化

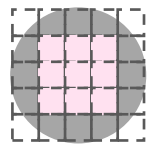


2) ウェハからパネルへ

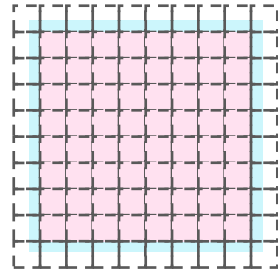
パッケージの大型化に伴い、生産効率が良い大型パネルへシフト

PLP(Panel Level Package)

φ300mmウェーハ



515mmx510mmパネル



3) ガラス材料の採用

熱で歪みにくく、配線の微細化・高速通信が可能な新材料

大面積・高精度実装を実現するPLPの重要性が増大

PLPを次世代パッケージの中核技術と位置づけ、
開発・事業投資を重点領域として集中。

ガラスPLP向け高精度塗布装置: TRENG-PLPコータ

ガラス基板に対する高均一塗布技術×搬送技術により、次世代PLPに対応



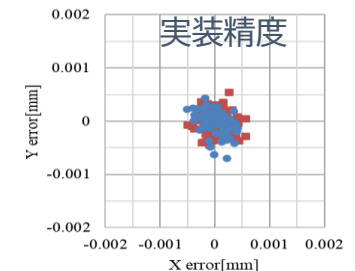
- ・高密度配線をガラスに成形するために、絶縁層、再配線層用液剤を均一な膜厚で塗布する装置
- ・液晶パネル業界でトップシェアである高精度塗布技術を半導体業界へ技術展開

PLP用熱圧着フリップチップボンダー: UC5000

大型パネル対応×高精度実装により、PLPでの優位性を確立

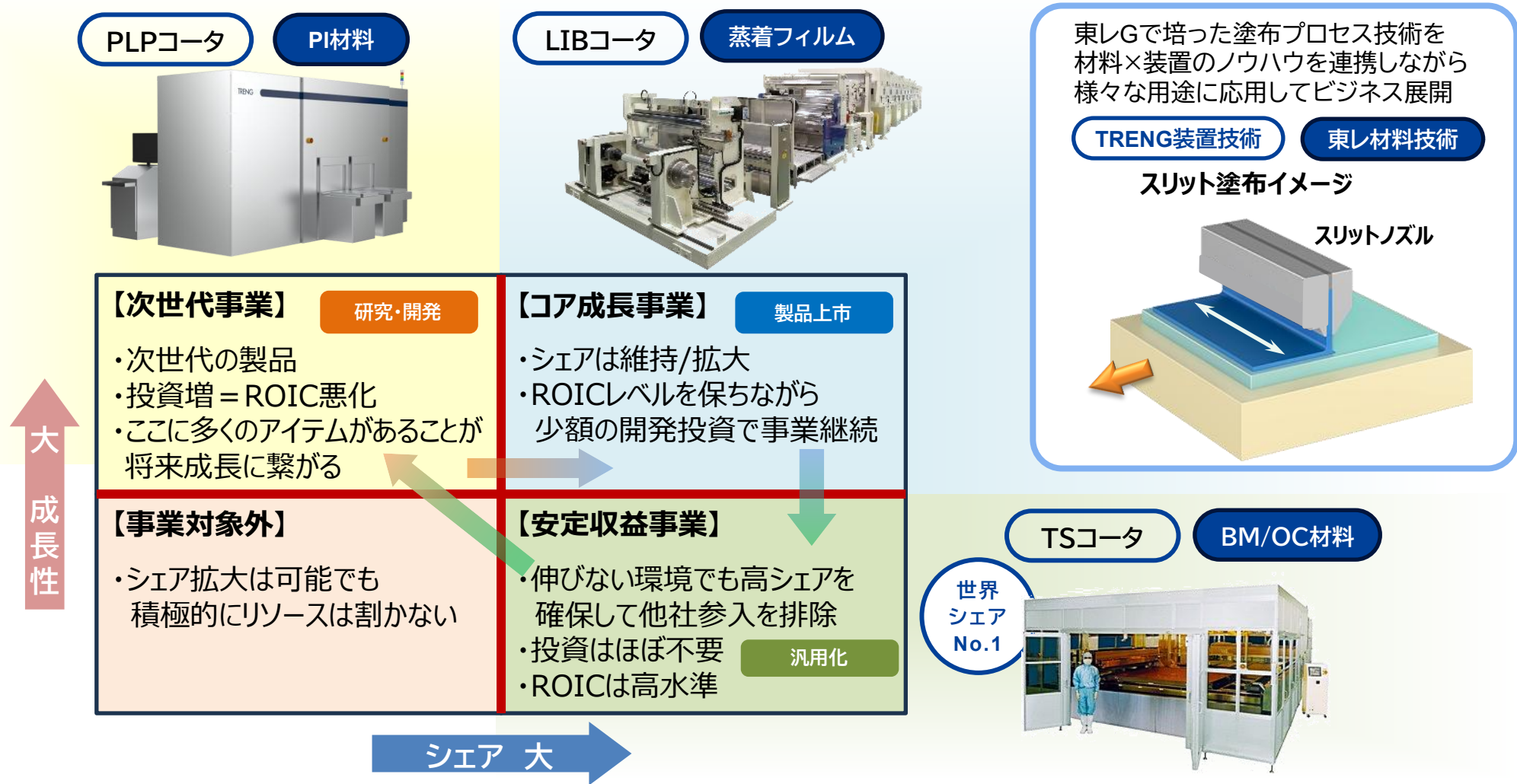


- ・半導体チップを高精度実装する装置
- ・業界最高精度である $0.8\mu\text{m}$ 以下(3σ)を実現



2-4. ROICを意識したビジネス展開と東レ材料技術との連携

- 変化の大きい事業分野では、回収の状況を見ながら各ポジションでの投資のバランスを取っていく。



Ⅱ -3

TRENG

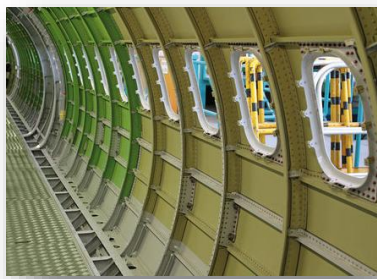
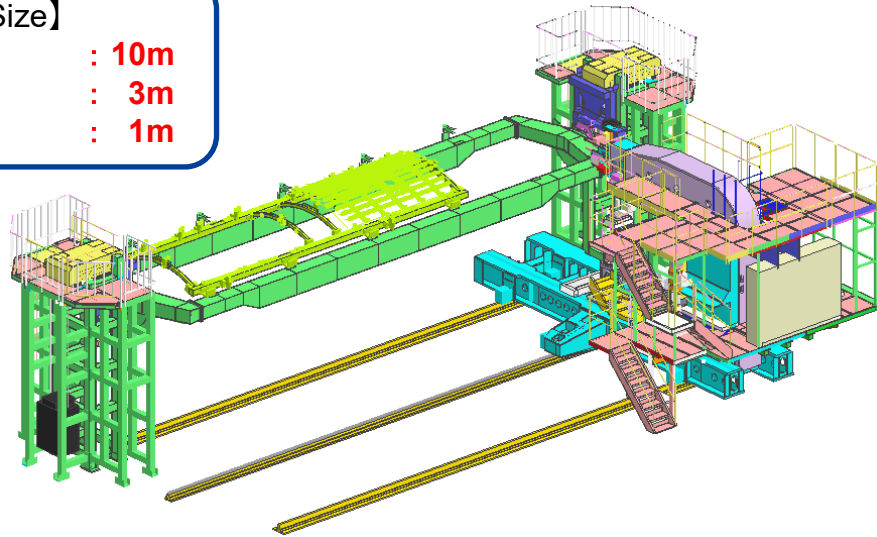
次世代・サステナビリティへの取り組み

1. 次世代への取り組み(航空機製造装置・スタートアップ企業との協業)

・航空機製造装置への取り組み強化:リベット装置への展開

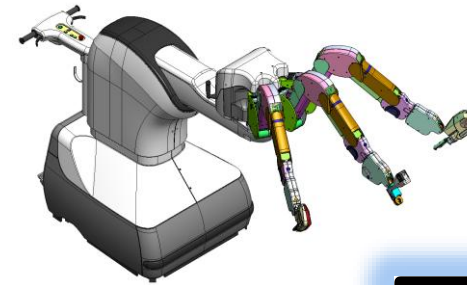
【Work Size】

Width : 10m
Depth : 3m
Height : 1m



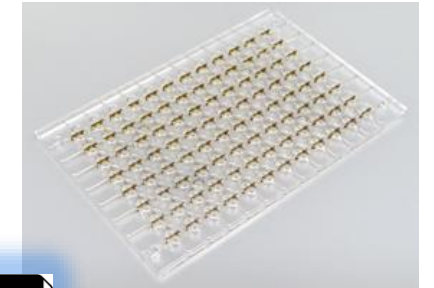
・スタートアップ企業との協業

RIVERFIELD



手術支援ロボット

MAQsys

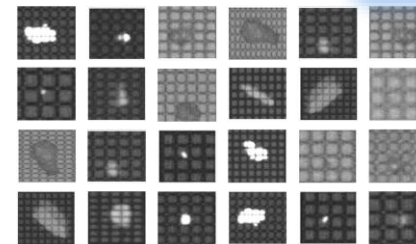


人工細胞膜チップ

TRENG

Solution by
Technology,
Engineering &
Know-how

LPIXEL



AI技術開発

東レエンジニアリングの技術とスタートアップ企業の技術との融合・連携を強化しながら将来事業を創出

2. “サステナブル・エンジニアリング”への取り組み

- 環境・社会・人を中心にした「サステナブル・エンジニアリング」を様々な製品に展開。

Sustainable Engineering

- 複合材3Dプリンター (CN, CE)
- 複合材貼り付け装置 AFP/ATL装置 (CN)
- ファクトリーオートメーション (CN, LI, DI)
- プラント建設 (CN, CE, NP, LI, DI)
- リチウムイオン電池製造装置(裁断) スリッター (CN)
- 太陽光発電事業 (CN)
- 生産・物流管理システム (CN, DI)
- 酸素濃度計 (CN, CE, DI)
- 水質分析計 (CN, CE, NP, LI)
- フィルム製造設備 (CE)
- 射出成形用混練ノズル 東レミキシングノズル (CN, CE)
- 樹脂成形シミュレーション 3D TIMON® (CN, CE, NP, DI)
- ディスプレイIDマーカータイトラー (DI)
- 半導体実装装置 フリップチップボンダー (CN, LI, DI)
- リチウムイオン電池製造装置(塗工) コーター (CN, CE, DI)
- 手術支援ロボットSaroaの製造 ※Saroaはリバーフィールド(株)の製品です (LI)
- 核酸医薬合成装置 Molecutideser® (LI, DI)
- ディスプレイ/半導体塗布装置 TSコーター (CN, CE, LI, DI)
- マイクロLEDディスプレイ製造装置 (CN, DI)
- 光学式ウェーハ外観検査装置 INSPECTRA® (CN, DI)
- 電子線式ウェーハ検査・計測装置 NGR® (CN, DI)
- 極薄チップ転写装置 (CN, DI)
- ポリイミドエッチング加工 (LI, DI)
- ファインパターン加工 (LI, DI)
- イオンチャネル創薬支援システム (LI, DI)

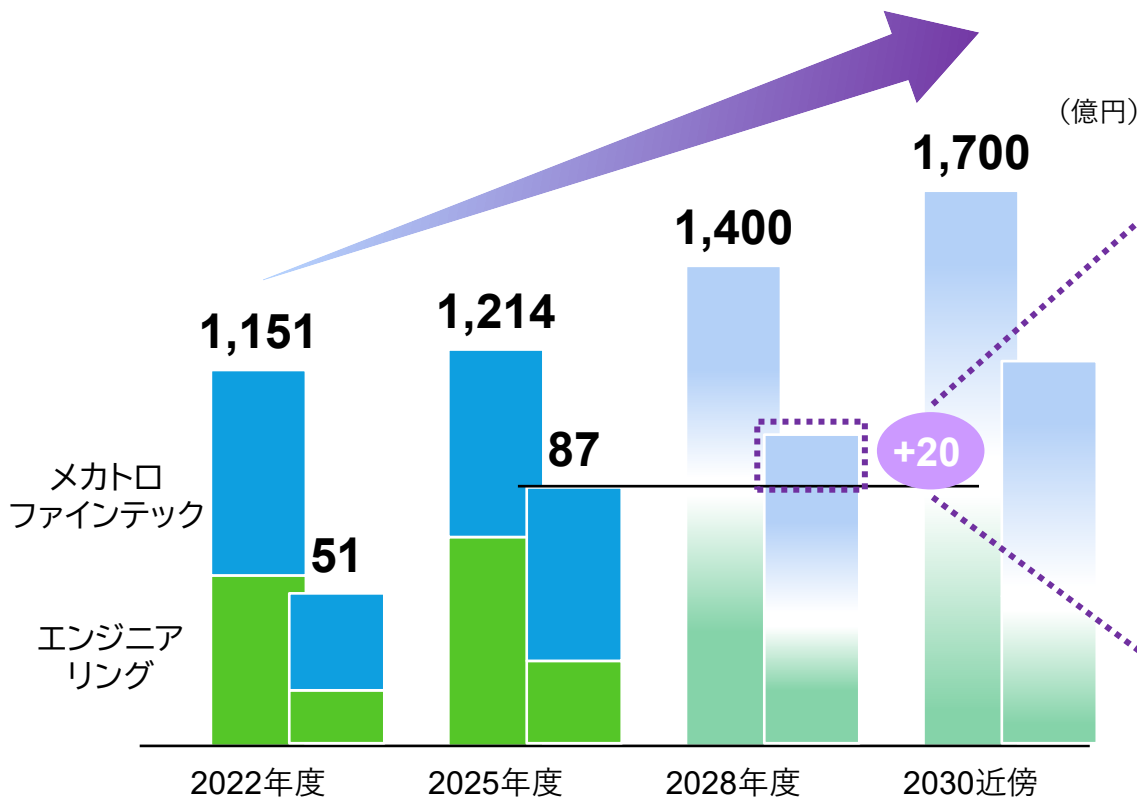
II-4

TRENG 目標

TRENG IGNITION 2028目標、将来展望

業績推移 (TRENG)

売上収益、事業利益



- AP-G 2025では、お客様の設備投資計画の見直し等から厳しい事業環境が続いたが、2022比で増収増益
- IGNITION 2028では、定置型用途のLIB製造装置、半導体関連装置の伸長を主因に売上収益1400億円、2030近傍では航空機関連装置をさらに拡大して1700億円への事業拡大を目指す

2028年度に向けた収益拡大については、以下の事業に注力した事業拡大に努める

【注力する事業と期待利益増分 (2025比)】

- ・LIB装置関連 (10%)
- ・半導体検査・計測機器関連 (20%)
- ・半導体製造装置関連 (25%)
- ・医薬、半導体材料プラント関連 (10%)

適宜注力事業の動向を見極めて、柔軟にポートフォリオを組み替えながら、利益率の改善に努めることで、さらなる増益の継続を実現

TRENGコーポレートサイト



<https://www.toray-eng.co.jp/>

TRENG 公式SNS



<https://www.youtube.com/@toray-engineering>

note



<https://note.com/treng657>

本資料中の業績見通し及び事業計画についての記述は、現時点における将来の経済環境予想等の仮定に基づいています。

本資料において当社の将来の業績を保証するものではありません。

'TORAY'
Innovation by Chemistry